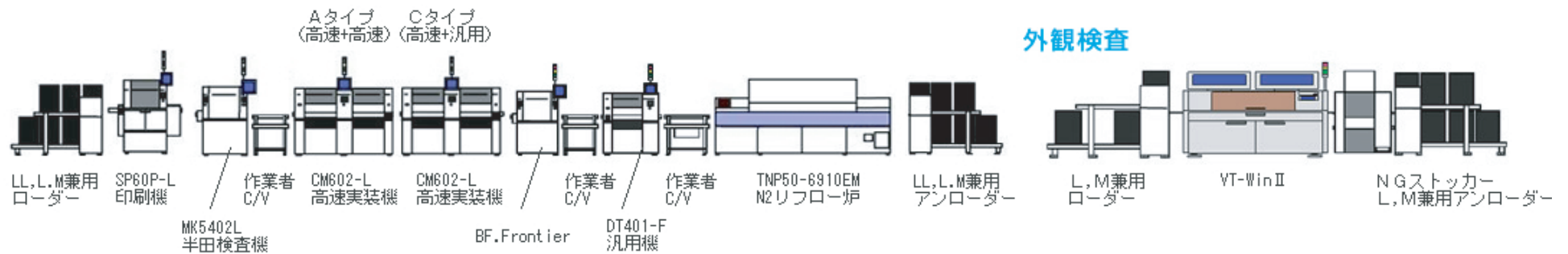


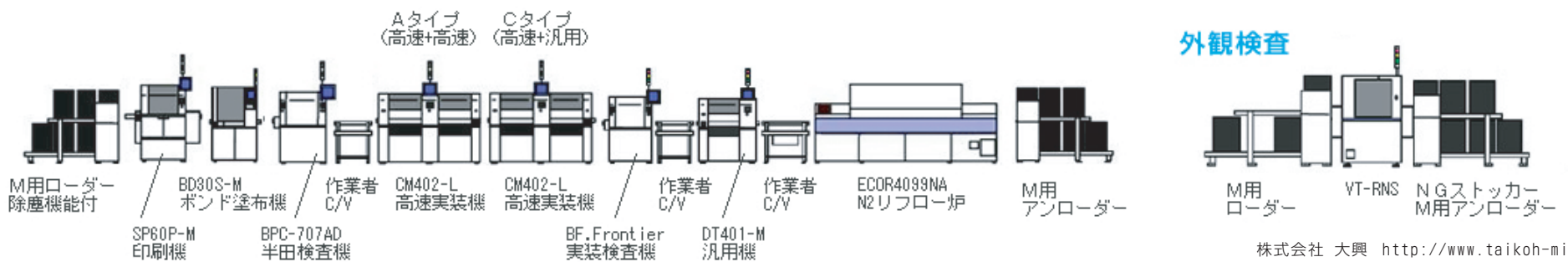
ライン名称	対象基板サイズ		対象部品	処理能力		
	Min	Max		月	日	時間
A	50mm×50mm	510mm×460mm	0603～PLCC 0.4mmピッチQFP ～0.5mmピッチCSP	30,000,000チップ°	1,200,000チップ°	50,000チップ°
B	50mm×50mm	330mm×250mm	0603～PLCC 0.4mmピッチQFP ～0.5mmピッチCSP	25,000,000チップ°	1,000,000チップ°	41,000チップ°
C	50mm×50mm	510mm×460mm	0603～PLCC 0.4mmピッチQFP ～0.5mmピッチCSP	30,000,000チップ°	1,200,000チップ°	50,000チップ°
D	50mm×50mm	510mm×250mm	0603～PLCC 0.4mmピッチQFP ～0.5mmピッチCSP	30,000,000チップ°	1,200,000チップ°	50,000チップ°
試作	50mm×50mm	460mm×360mm	0603～PLCC 0.4mmピッチQFP ～0.5mmピッチCSP	14,100,000チップ°	564,000チップ°	23,500チップ°

2012年5月現在

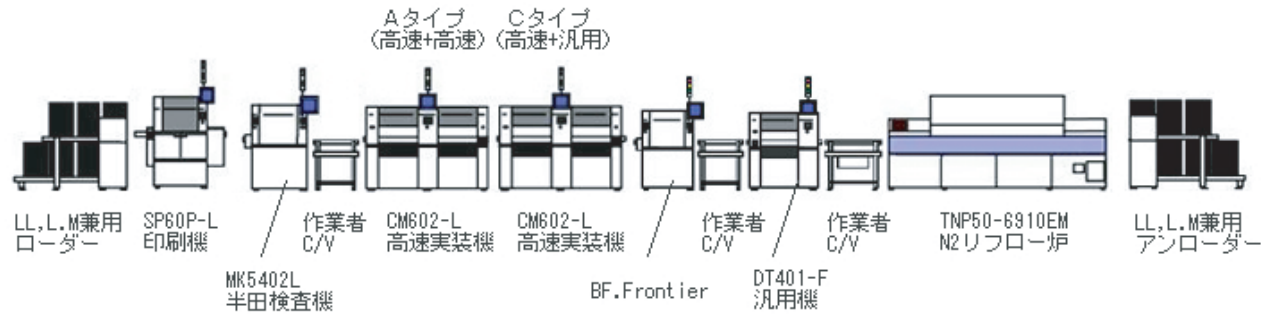
Aライン



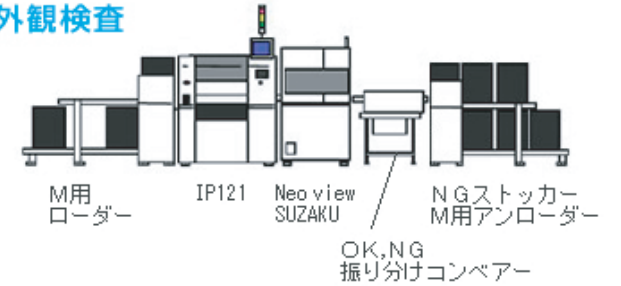
Bライン



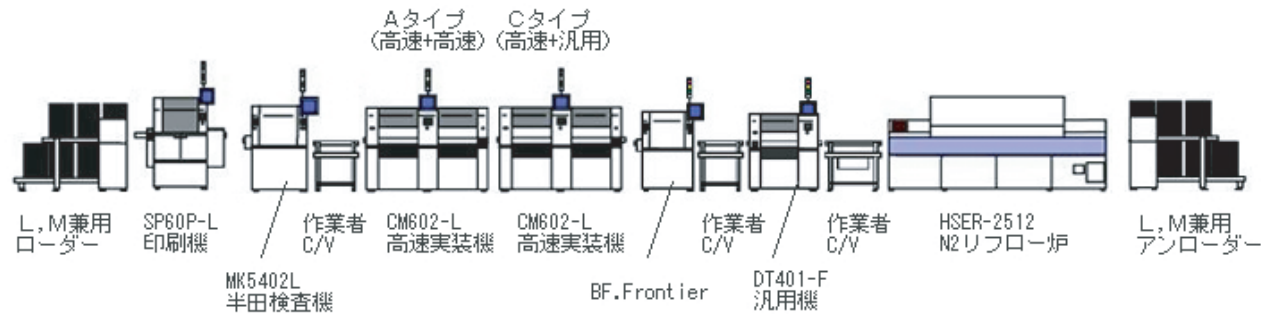
Cライン



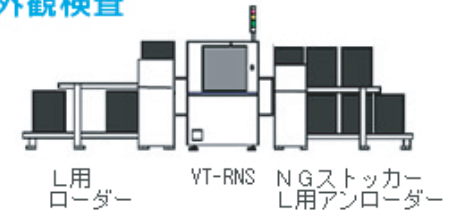
外観検査



Dライン



外観検査



試作ライン

